

반도체·디스플레이공학전공

차세대반도체융합공학부

차세대 반도체융합공학부 반도체 디스플레이 전공에서는 국내 최고수준의 교수진을 통한 산학연계 실습중심의 교육과정을 통하여 미래기술을 선도해나갈 창의적인 인재를 교육합니다.

학과 설립연도(년) | 모집인원수(명)
2025 | **30**



장학금 제도

교내 | 첨단융합인재, 미래설계
 교외 | 교외단체, 향토
 국가 | 국가(이공계), 국가(가계 곤란1, 2유형), 국가(푸른등대 기부장학), 국가(근로), 보훈, 북한이탈주민



CHECK POINT!

학과활동

- 반도체 및 디스플레이 학부연구생, 반도체장비 분석 프로그램 운영
- 산학협력프로그램 : MiLEDi ICC 운영
- 학과부설연구소: 마이크로LED디스플레이 연구센터(차세대 디스플레이 연구를 위한 실습센터 보유 및 운영)

미래 AI기술과 ICT기술의 가장 중심이 되는 반도체와 디스플레이 분야의 창의적인 변화를 이끌어갈 인재 양성

무엇을 배우나요?

졸업 후 진로

학년별 CURRICULUM

- 1 첨단반도체창의아이디어, 일반물리학1·2, 일반물리학실험1·2, 일반화학1·2, 일반화학실험1·2, 미분적분학1·2
- 2 광전자실험, 나노반도체실험, 양자전자학, 전자기학1·2, 기초전자회로, 물리화학, 신소재공학개론1, 전자재료물성, 반도체소자물리, 공학프로그래밍1, 공업수학1·2
- 3 첨단반도체캡스톤디자인1, 미세조직실험, 반도체소자및공정실험, 광공학개론, 레이저공학, 반도체소자, 반도체공정, 전자회로및제어, 실리콘집적회로공정, 나노전자학, 디스플레이공학, 고급박막공정, 공학프로그래밍2, 연구실심화실습1·2

- 4 첨단반도체캡스톤디자인2, 첨단반도체세미나, 디스플레이실험, 차세대반도체현장실습, 반도체패키징공정, 광전자응용, 광전자융합공학, 전자기파전송공학, 광반도체응용, AI반도체소자, 디스플레이광학, 미래디스플레이공학, 반도체특성분석, 박막및분광분석, 글로벌공학리더십, 연구실심화실습3·4



수상실적

- 2024년 디스플레이 부트캠프 주관학과
- 2024년 반도체 부트캠프 참여학과
- 2023년 HYU우수학과
- 2021~2024년 교육부 BK21 FOUR 교육사업단 참여



첨단융합대학 교양필수

AI 소양	기초 소양	진로설계
<ul style="list-style-type: none"> · 시리터러시 · 오픈소스AI · AI+X공학융합프로젝트 · AI의이해 · 고급파이썬과인공지능 	<ul style="list-style-type: none"> · 학술영어 · CORE기초 · 아카데미글쓰기 · 사회혁신을위한ESG와 DGs의이해 	<ul style="list-style-type: none"> · 취업진로세미나 · IC-PBL과비전설계 · IC-PBL과취창업을위한 진로탐색 · IC-PBL과역량개발

차세대반도체분야의 실무적 현장전문가(엔지니어), 대학과 연구소의 핵심전문연구원, 반도체분야 기업의 연구원 또는 임직원(CTO,CIO,전문연구원), 차세대반도체를 위한 소재·소자·공정분야 스타트업 창업가



주요 취업처

삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, 현대자동차, ASML, 램리 서치, 어플라이드머티리얼즈, 원익IPS 등